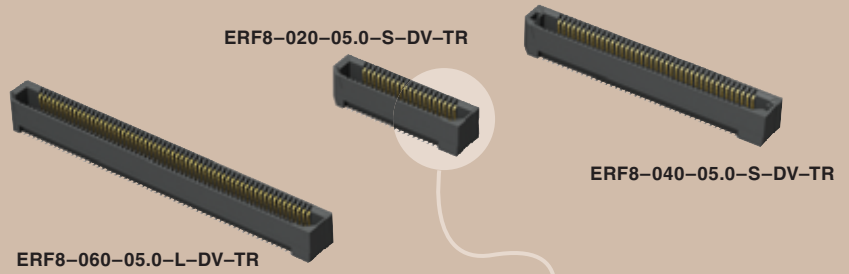




(0,80mm) .0315"

ERF8 系列



紧固型高速插座

技术规格

如需了解完整技术规格以及所设计的 PCB 布局, 请浏览 www.samtec.com?ERF8

绝缘体材料:
黑色液晶聚合物



触点材料:
镀铜
电镀:
在 50μ" (1,27μm) 的镍上
镀金或锡
额定电流:
85°C 时为 2.1A
工作温度范围:
-55°C 至 +125°C
额定电压:
最大 200 VAC
符合 RoHS 规范要求:

加工:
可无铅焊接:

SMT 引线共面性:
(0,10mm) .004" 最大 (005-030)
(0,12mm) .005" 最大 (040-060)
(0,15mm) .006" 最大 (070-075)

电路板配接:
ERM8

缆线配接:
ERCDA, ERDL2,
ERCD, ERDP

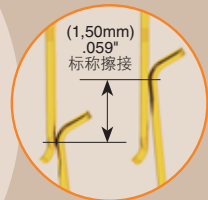
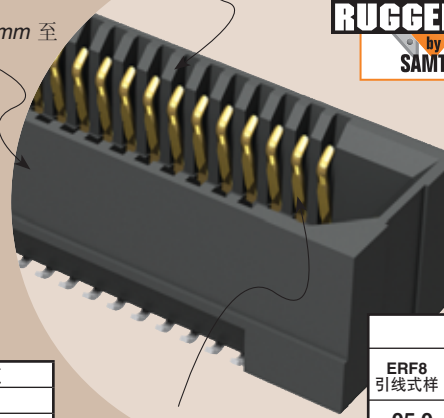
堆叠高度从 7mm 至 16mm



0,80mm ERM8/ERF8	在 3dB 插入损耗的额定值
7mm 堆叠高度	
单端信号	10.5 GHz / 21 Gbps
差分对信号	9.5 GHz / 19 Gbps
如需完整测试数据, 请浏览 www.samtec.com?ERF8 或联系 sig@samtec.com	



- Edge Rate™ 触点
- 锁紧选项
- 延长的导柱选项



ERF8 引线式样	堆叠高度*			
	ERM8 引线式样			
-02.0	(7,00) .276	(10,00) .394	(13,00) .512	(14,00) .551
-05.0	(9,00) .354	(12,00) .472	(15,00) .591	(16,00) .629

*加工条件将影响配接高度。

坚固的边缘速率触点提高了“拉锁式”拔出力

ERF8 每排位置数 引线式样 电镀选项 DV 其他选项 TR

-005, -010, -013, -020, -025, -030, -040, -050, -060, -070, -075

从图表中指定引线式样

-L = 触点 镀 10μ" (0,25μm) 金, 焊尾镀雾锡
-S = 触点 镀 30μ" (0,76μm) 的金, 焊尾镀雾锡

-L = 锁紧 (仅限引线式样 -05.0) (-EGP 选择不提供)

-EGP = 加长导柱 (仅限引线式样 -07.0) (-L 选择或 -013, -025 位置不提供)

-EGPS = 延长的导柱屏蔽 (仅限引线式样 -07.0) (-L 选择不提供) (仅限 -010, -020, -025, -030 位置)

-K = (6,00mm) .236" 直径的聚酰亚胺膜取放垫

-TR = 卷带封装

引线式样	A
-05.0	(5,10) .200
-07.0	(7,00) .276

支持的协议

PCI Express®

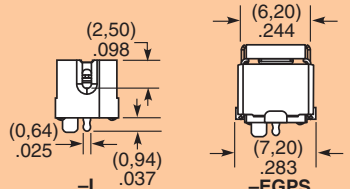
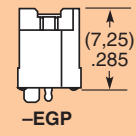
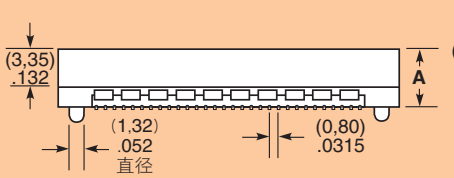
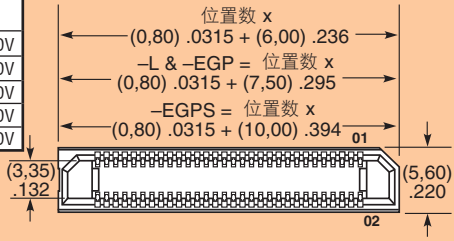
登录 www.samtec.com/appnote 下载应用注释

与 SIG @ samtec.com 联系 了解有关协议的问题

标准	位置数	零件编号	系列
NEXUS5001™.org	11	ASP-137969-01	ERF8-DV
POWER.org™	17	ASP-130368-01	ERF8-DV
ARM/HSSTP	20	ASP-130367-01	ERF8-DV
NEXUS5001™.org	23	ASP-130368-01	ERF8-DV
POWER.org™	35	ASP-135029-01	ERF8-DV

特殊应用选项

可提供其他位置数和夹层堆叠高度。请致电 Samtec。



注: 有些长度、式样和选项为非标准型, 不可退换。